



# 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614  
2022年8月10日

## 売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

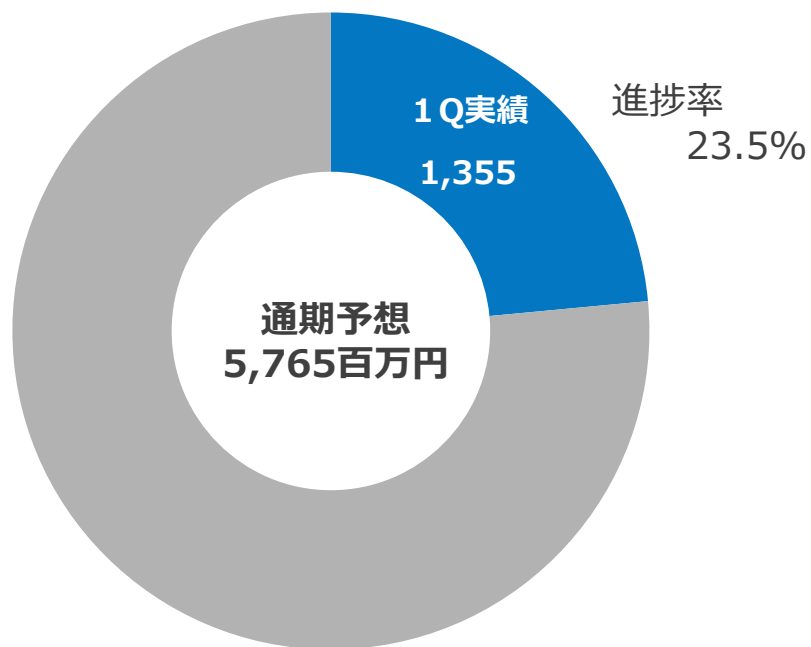
- 今第1四半期は材料調達の影響をコンサバティブに予想していたが、予想を上回る進捗。当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があるが、進捗率に関しても順調にスタート。
- 売上高は、新型コロナによる活動制限や材料納期遅延を対策により影響を最小限に抑え、1Q計画比及び前期比でも増収。
- 経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、1Q計画比及び前期比でも増益。下期のウェイトが高いが、通期での進捗は12.7%と順調。（前期比+2%）
- 受注は引き続き好調であるが、部品の長納期化の影響を考慮し、業績見通しは据え置く。

（単位：百万円、%）

	2023/3期 通期予想		2023/3期 1Q実績		計画比
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率
売上高	5,765	100	1,355	100	23.5
売上総利益	1,521	26.4	322	23.8	21.2
販管費	1,110	19.3	272	20.1	24.5
営業利益	410	7.1	49	3.7	12.1
営業利益率	7.1		3.7		—
営業外損益	22	0.4	5	0.4	23.6
経常利益	433	7.5	54	4.1	12.7
減価償却費合計	103	1.8	23	1.7	22.8
当期純利益	337	5.9	33	2.5	10.0

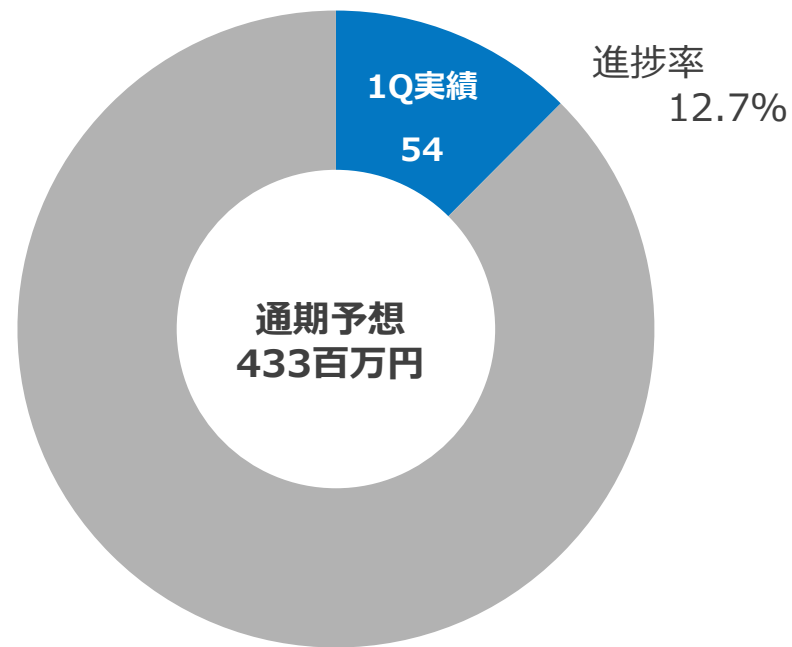
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

(単位：百万円)

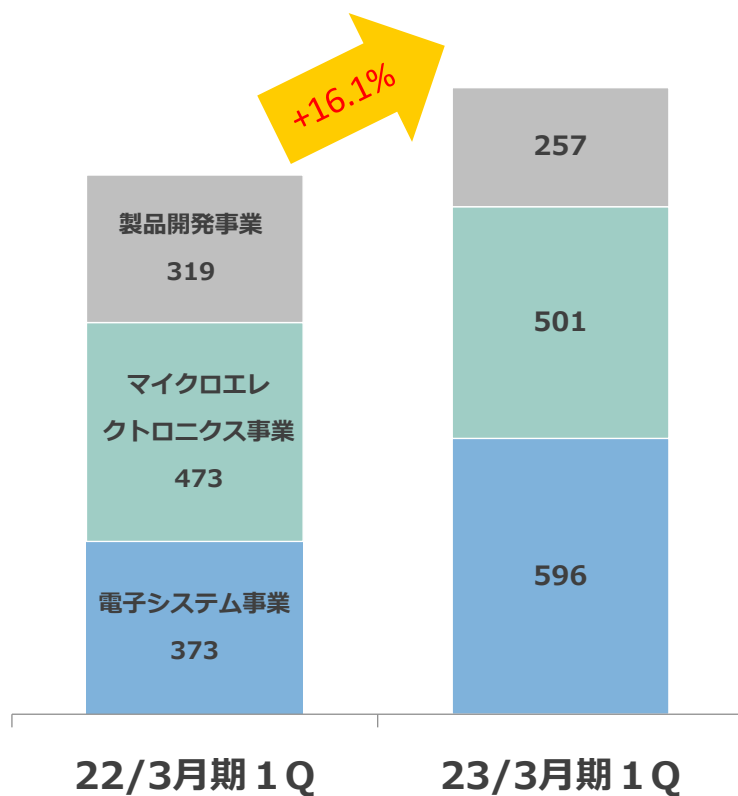


※ 1Qまでの実績は順調に推移。

半導体生産増による半導体後工程商材、新製品用カスタムバーンインの受注が増加し電子システム事業が大幅増収。マイクロエレクトロニクス事業も堅調に推移。

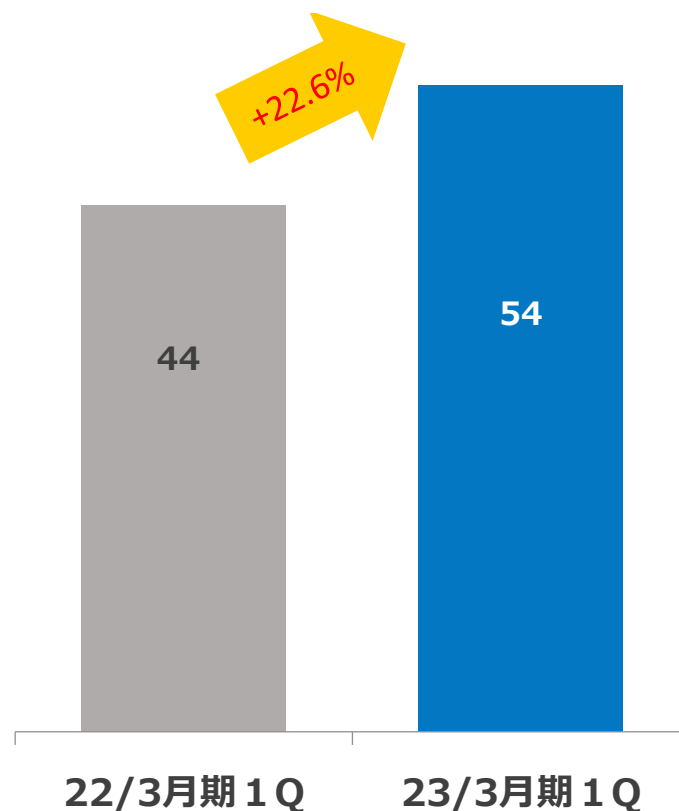
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

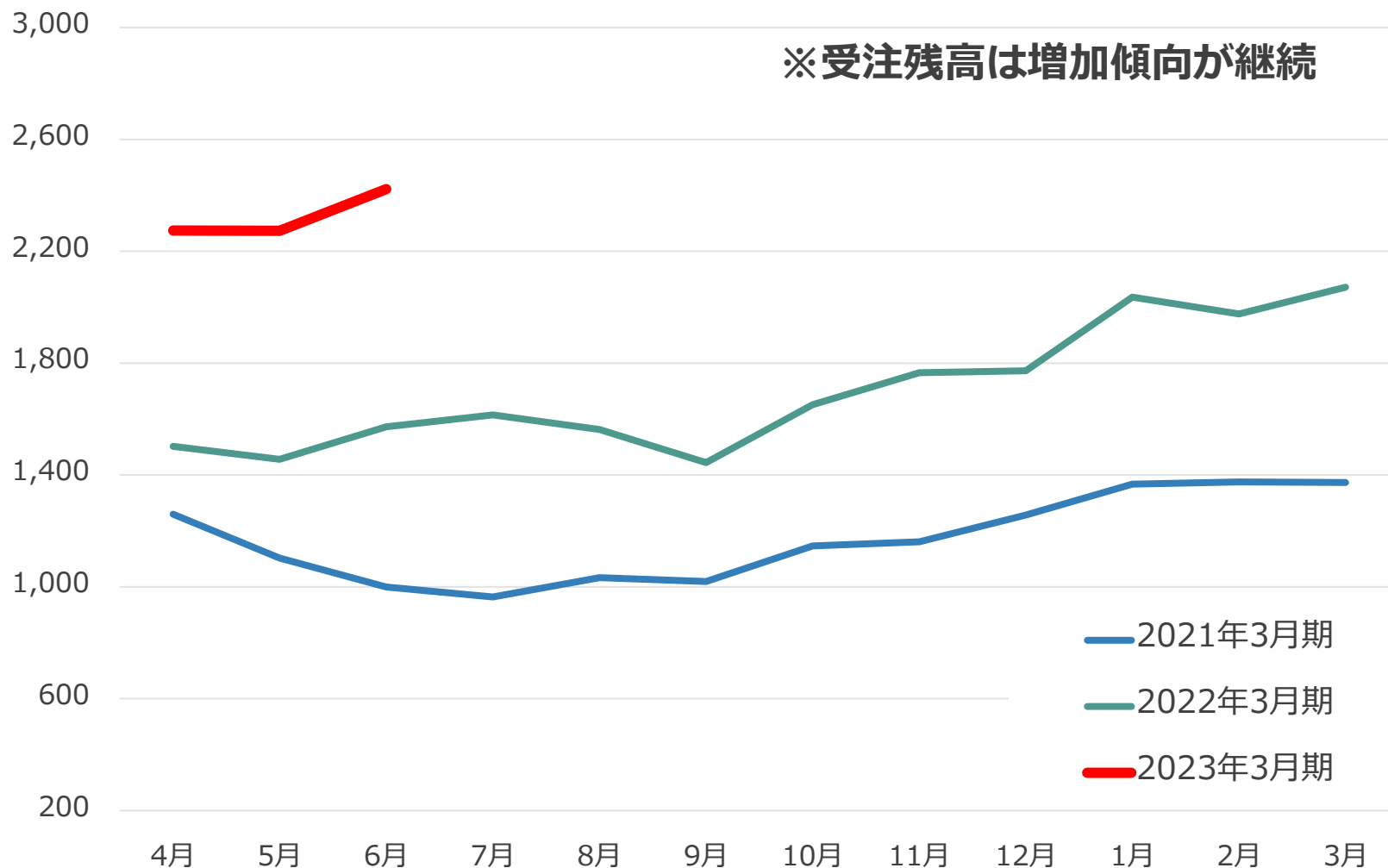
(単位：百万円)

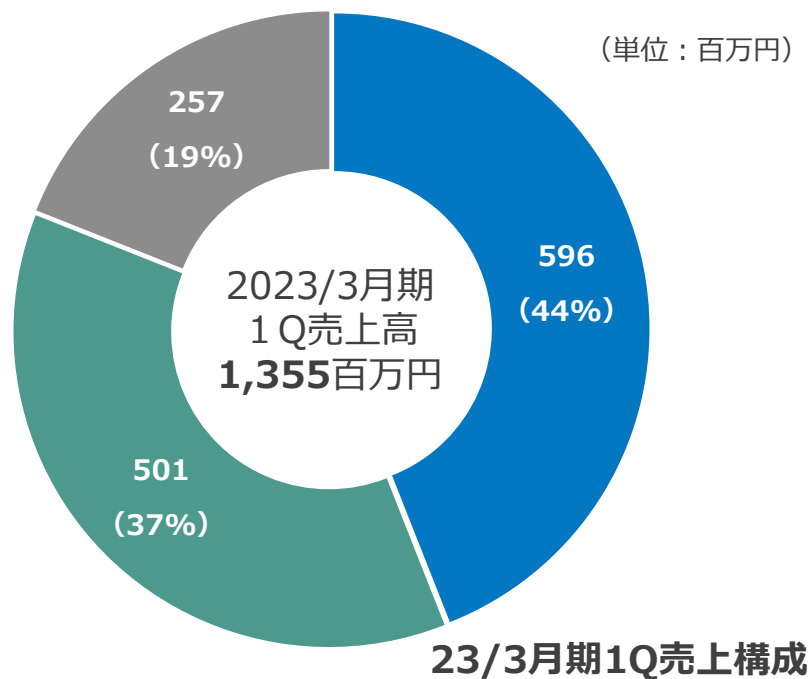


※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

## 【受注残高（全社）】

（単位：百万円）





## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

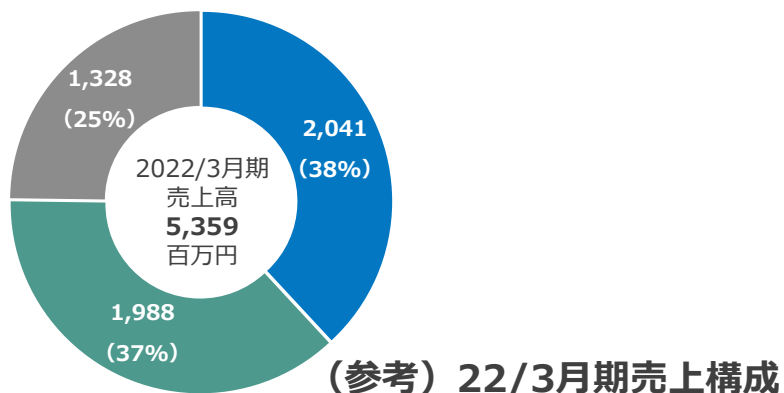
### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

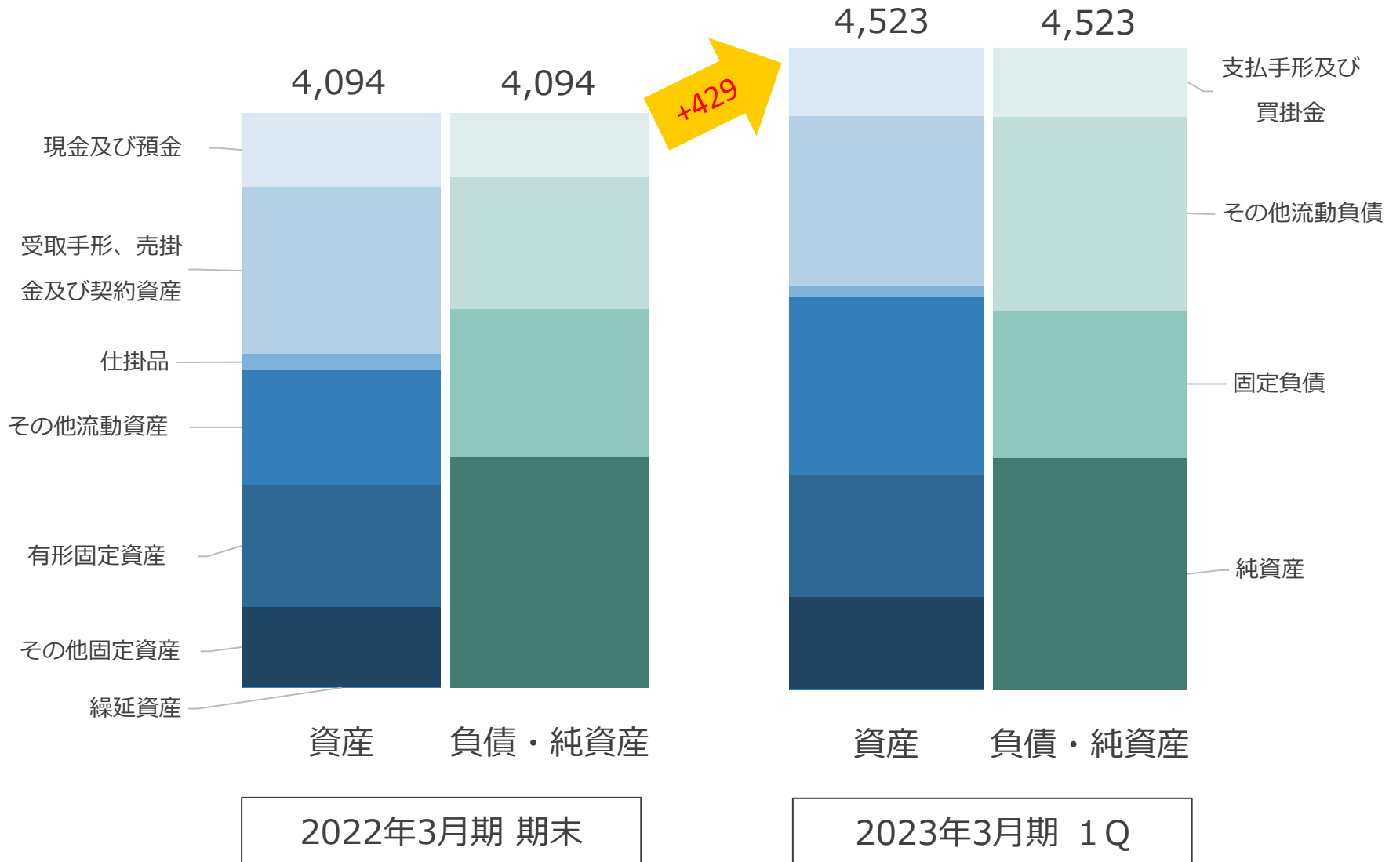
## 製品開発事業

### 製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール



(単位：百万円)



## 2022年

4月 1日 福岡デザインセンターを拡張

4月 4日 東京証券取引所 新市場区分変更より「スタンダード市場」に変更

5月13日 決算発表

画像処理のAI 応用に最適な画像処理半導体IPコアをリリース

5月24日 富山県魚津市に工場物件の取得を取締役会決議し、情報開示

6月 7日 3Dセンシングに先進的な技術を保有するMagikEye Inc.と資本業務提携

6月 9日 決算説明会

6月24日 第50期 定時株主総会

7月 1日 ルネサス エレクトロニクス株式会社「RZ パートナエコシステム」に加入

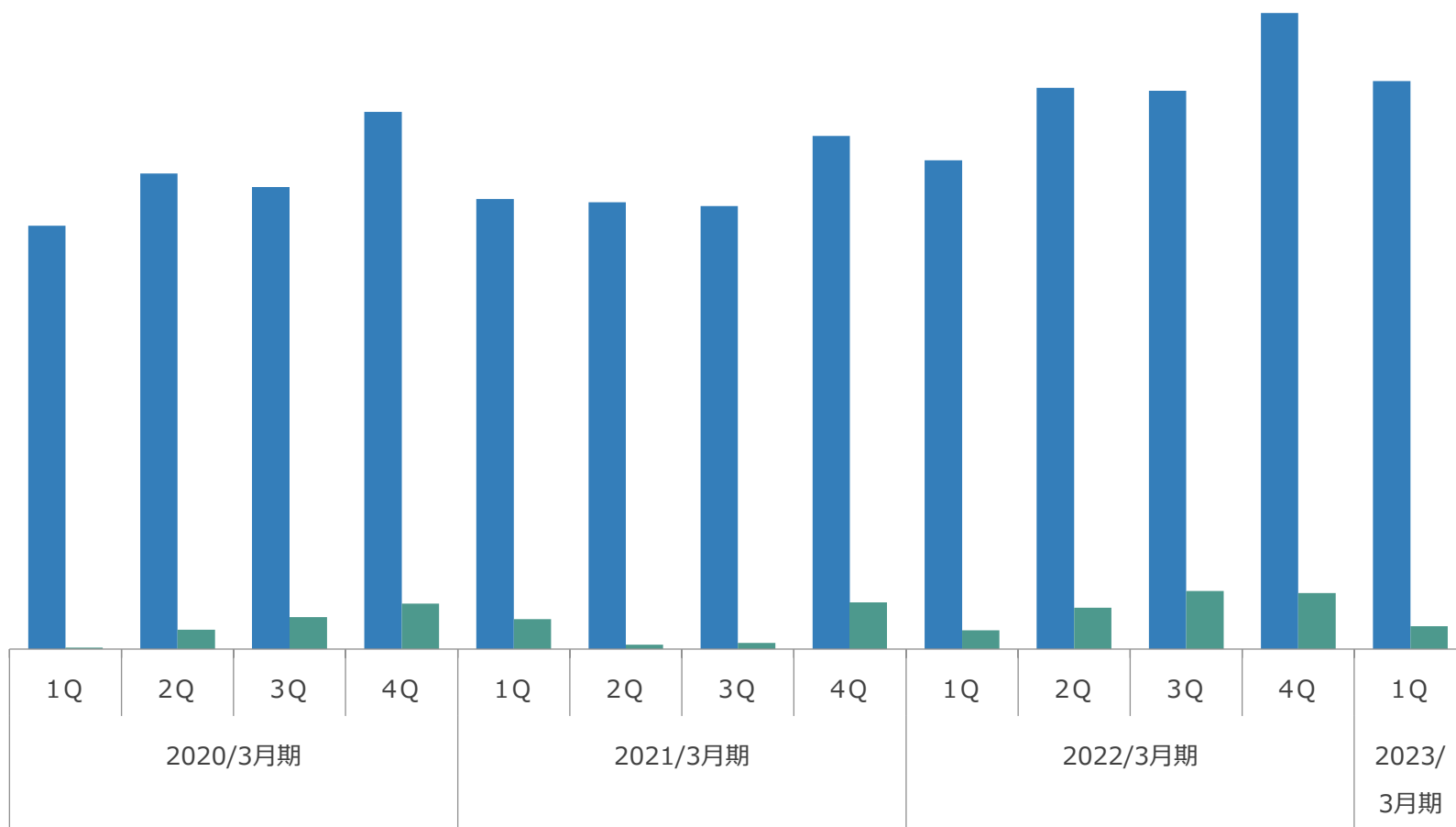
7月 7日 熊本県熊本市に新規事業所を設置・事業開始

1Q

2Q



■ 売上高 ■ 経常利益

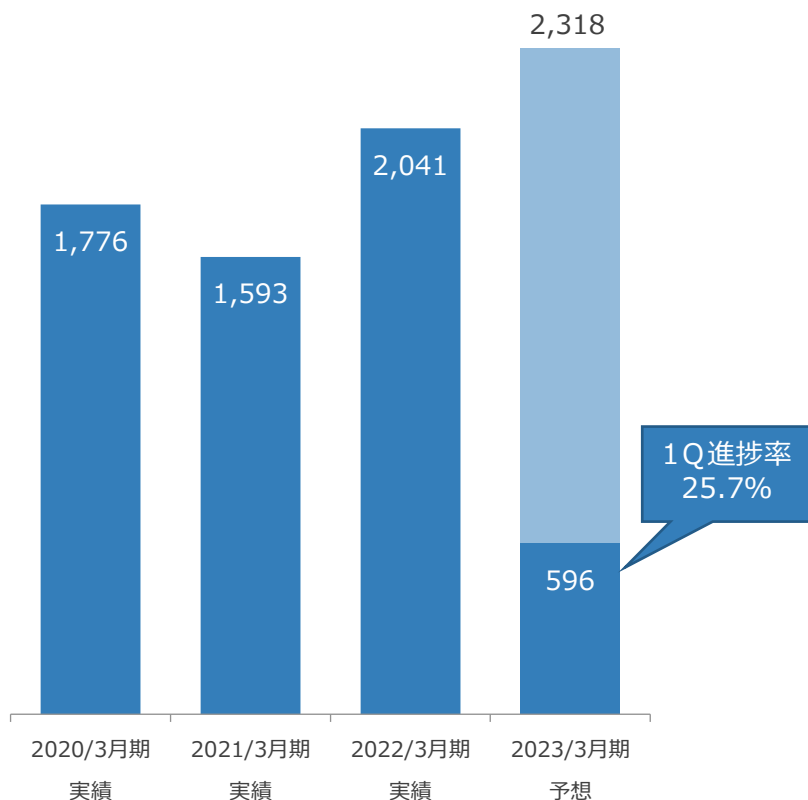


※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

半導体生産増に対する後工程商材の受注増、半導体新製品用カスタムバーンイン商材の受注増に加え、車載製品用専用計測機器の受注が堅調。

## 【売上高】

(単位：百万円)



## 1Qトピックス

➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注増



**バーンインボード**  
前期1Q比：253%



**半導体検査装置販売・リース**  
前期1Q比：230%



**車載製品用専用計測機器関連**  
前期1Q比：125%

➤ 魚津工場近接地に工場を取得。

敷地面積：2,538m<sup>2</sup>  
延べ床面積：1,276m<sup>2</sup>



➤ HD-PLCアライアンスにおいて  
一般会員から主要3社で



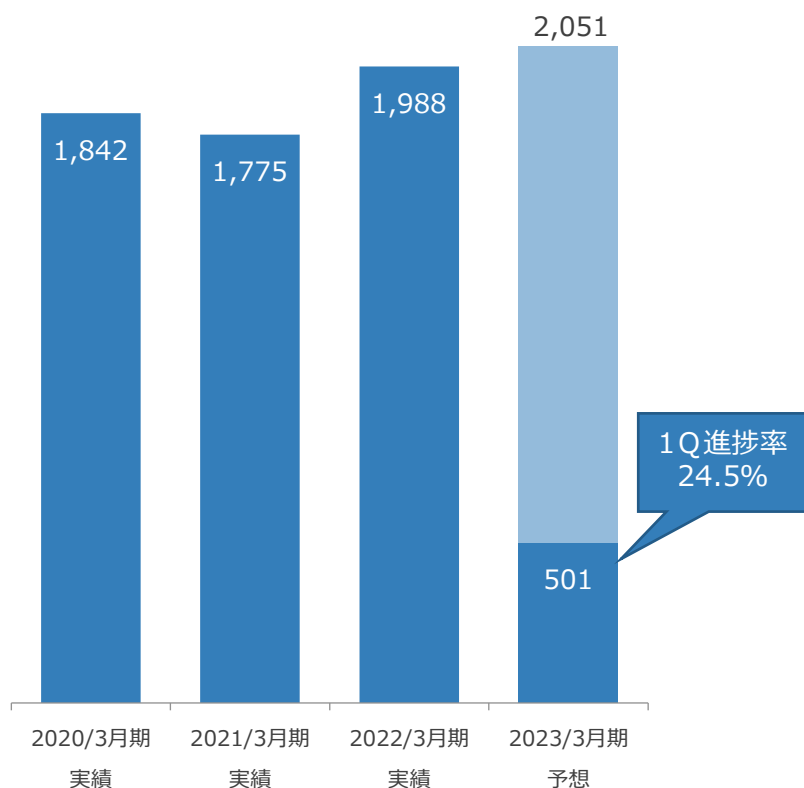
構成される推進会員に変更。  
➤ JECA FAIR 2022 電設工業展  
にHD-PLCアライアンスブース出展。



旺盛な半導体需要に支えられ、アナログはパワー半導体、デジタルは画像処理関連の設計需要が堅調に推移、画像処理IPの商品組み込み完了し売上に貢献。

## 【売上高】

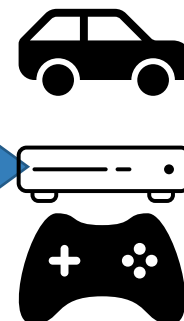
（単位：百万円）



## 1Qトピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

汎用商品向けパワー半導体関連  
アナログ設計受託  
前年同期比：214%

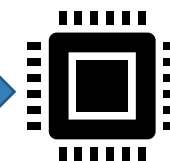


### ➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
前年同期比：171%



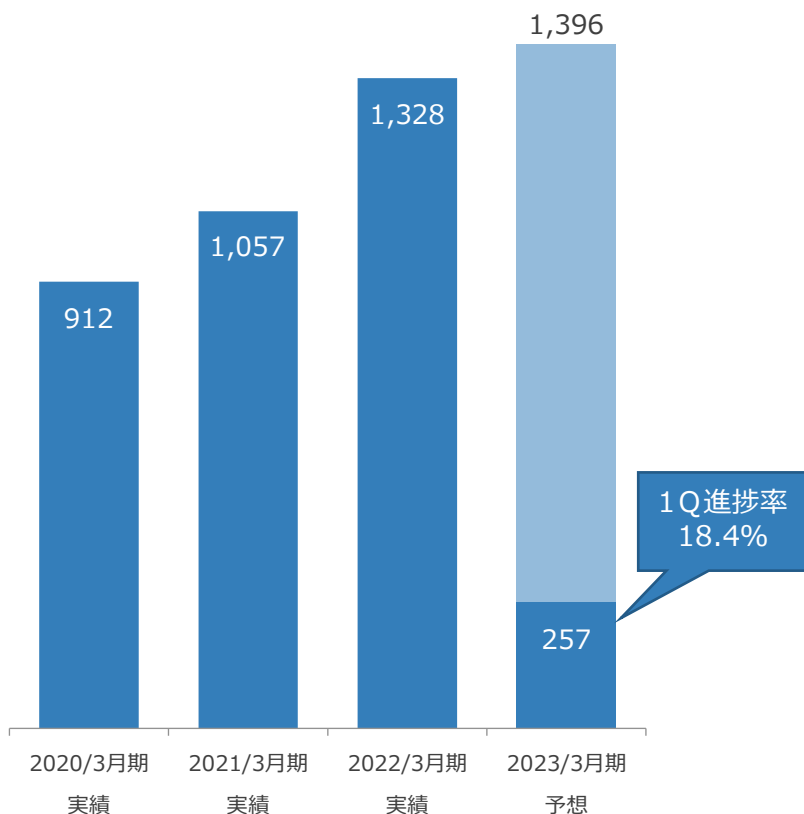
画像信号処理-IP  
組み込み完了



自動車など国内の設備投資復調により生産検査用途向け出荷が増加。新製品がヘルスケア機器に採用、出荷を開始。MagikEye社との資本提携で3Dセンシングカメラモジュールの開発を開始。

【売上高】

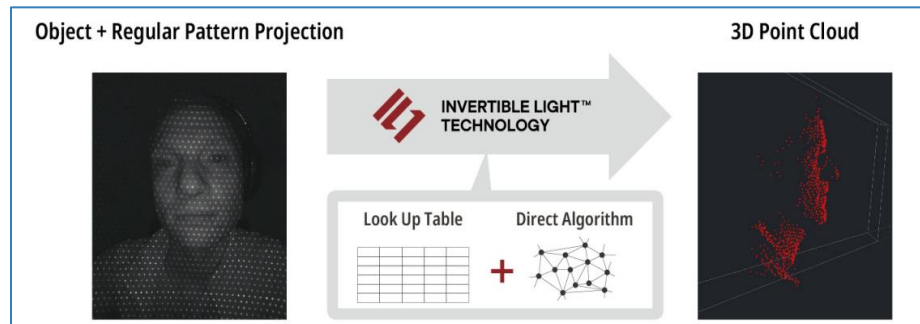
(単位：百万円)



## 1Qトピックス

### MagikEye Inc.(米国) と 3Dカメラモジュール共同開発を開始

MagikEye Inc.の **INVERTIBLE LIGHT™** を搭載



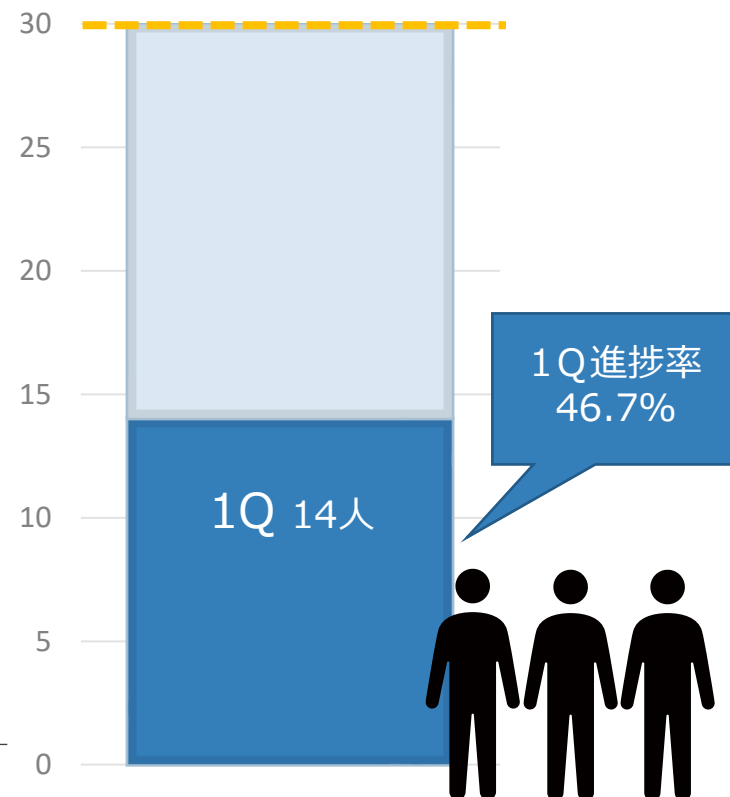
### 特長

- 1センサで2D+3D同時出力を実現
- 小型3Dモジュール
- レイテンシ小、高い電源効率

2023年度サンプル販売開始を予定

- 好調な受注環境と成長に対応するため、人員増強を図っております。
- 通期で30人（技術：18人）の採用計画  
1Qまで 14人（技術：9人）を採用

人員  
通期採用計画：30人

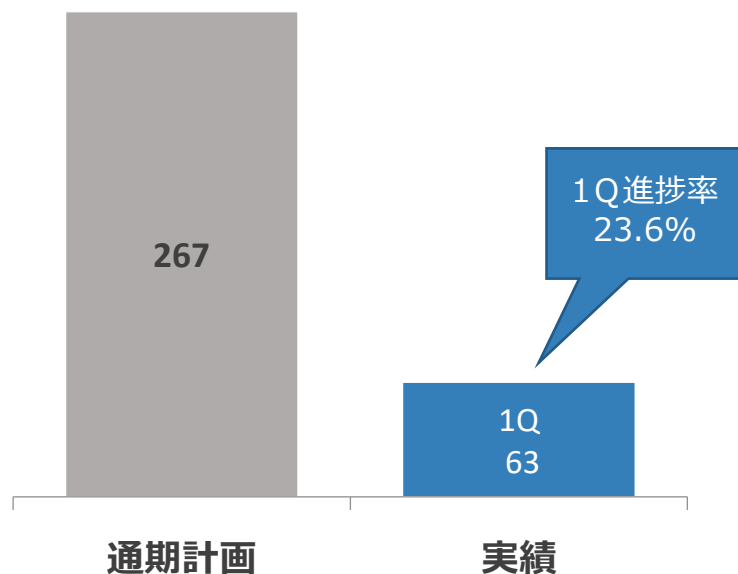


研究開発に投下している「工数」は順調に進捗しています。

研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

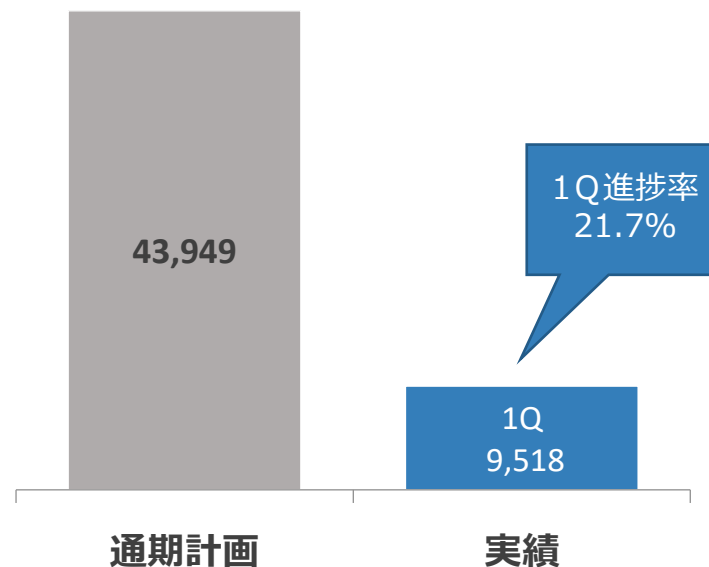
## 【研究開発費】

(単位：百万円)



## 【研究開発工数】

(単位：H)



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組みます。

## 研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、  
IPコア、高速IF回路、  
画像処理システム、カメラの性能向上、  
新機能開発

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置  
IoT-PLC通信モジュール

### マイクロエレクトロニクス事業

- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## ご注意事項

### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

## お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/